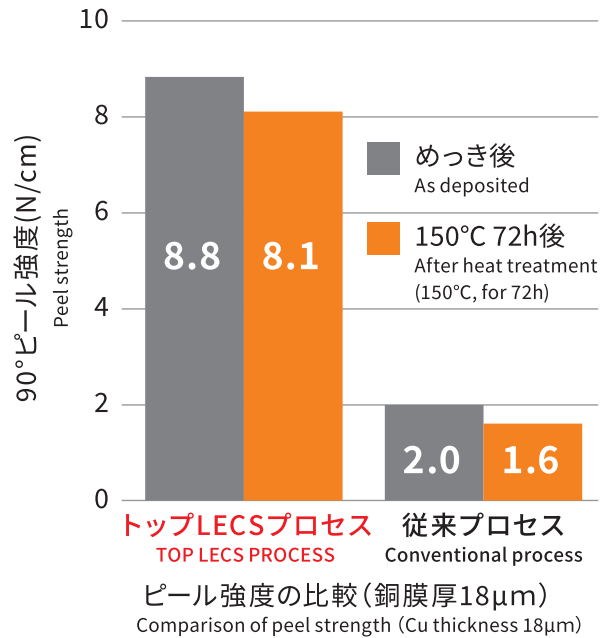
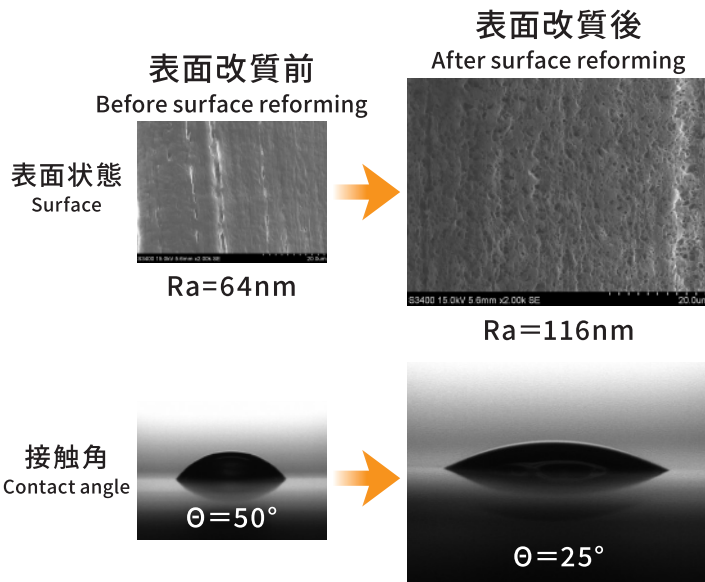


液晶ポリマー(LCP)への無電解銅めっきプロセス Electroless Copper Plating Process to LCP

トップLECSプロセス TOP LECS PROCESS

- 高周波高速伝送に適したLCPフィルムへのめっきプロセス
Realize plating to LCP films suitable for high-frequency, high-speed transmission
- 全湿式プロセスであり、無電解銅めっきが直接可能
All steps : Wet process/Realize direct electroless copper plating on LCP films
- 表面改質層を形成することで良好な密着性を得る
Obtain high adhesion power by surface reforming
- セミアディティブプロセスに対応し、ファインパターン性に優れる
Applicable for SAP and excellent in fine pattern ability

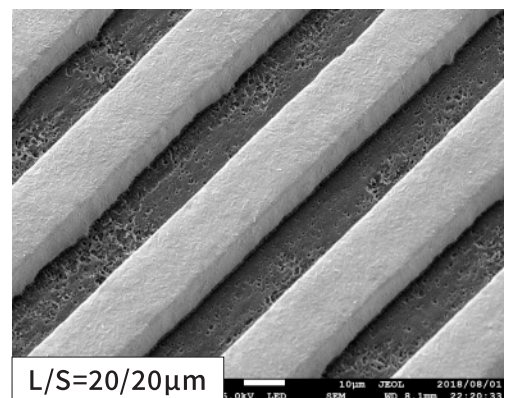
低粗度でも高いピール強度が得られ、高速伝送に適する
High peel strength to low Ra material, suitable for high-speed transmission



素材にめっきが直接できる
Can plate on LCP directly

表面改質 Surface reforming	トップLECSプリコンディショニング TOP LECS PRECONDITION
コンディショニング Conditioning	トップLECSコンディショナー TOP LECS CONDITIONER
プリディップ Pre-dipping	トップLECSプリディップ TOP LECS PREDIP
触媒付与 Catalyzing	トップLECSキャタリスト TOP LECS CATALYST
活性化 Accelerating	トップLECSアクセレーター TOP LECS ACCELERATOR
無電解銅めっき Electroless copper plating	トップLECS銅 TOP LECS COPPER

ファインパターン形成が可能
Excellent in fine pattern ability



パラジウム吸着量が低くパターンニング性に優れる
Reduce Pd adsorption amount,
excellent in patterning performance